

ビアメカニクス(株)プリント基板用 レーザ加工機発売のお知らせ 新世代のパッケージ基板加工を高精度・高生産性で実現

プリント基板加工機メーカーであるビアメカニクス株式会社は、レーザ加工機の新製品として、2016年6月20日、ハイエンドパッケージ基板向けのLC-4NT252を正式に発売いたします。

【開発の背景】

スマートフォンなど、ハイエンド電子製品に使用されるデバイス部品の急速な進化に伴い、従来の基板穴あけ技術とは一線を画する、超高精度加工のニーズが高まっています。この新世代技術へのソリューションとして、当社が総力を挙げて研究開発、満を持して市場投入する、業界最高位の新型機がこのLC-4NT252です。

【特長】

1. 業界トップクラスの高精度

機械本体設計の抜本的向上、高度な補正技術により、ウェアレベルPKG加工に匹敵する超高精度を実現致しました。 ガラスマスタ合わせ精度: Ave.+4 σ ≤ 8 μ m

2. 業界最速、20,000穴/秒の圧倒的高生産性 (当社従来機比180%)

Cuダイレクト加工では業界初の2パネル4ビーム機です。高出力レーザ発振機搭載、新光路設計等による加工制御の進化で生産性が飛躍的に向上しました。

3. 精度安定性の向上

高剛性設計の本体からレーザ源、ガルバノミラー等のキーパーツまで、加工安定性の為にあらゆる要素を最適化、超高精度と長時間安定性を両立しました。

4. 加工条件選定のアシスト

当社の長年に渡る経験値、加工ノウハウを蓄積した最新ソフトウェアにより、最適な加工条件を自動生成、装置側からユーザーに提案する機能を搭載しました。



急速に進化していくプリント基板加工プロセスに、様々な形で応えるべく、
当社は2016年度中に、新たに二機種、新製品の販売開始を予定しております。
常に「最新」を発信する当社の技術にご期待ください。

本件に関するお問い合わせ先:

ビアメカニクス株式会社 経営戦略本部 マーケティング部
松橋安里 e-mail:a.matsuhashi@viamechanics.com
Tel:046-235-9714